



平成 24 年 8 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社日立ハイテクノロジーズ
代 表 者 執行役社長 久田 眞佐男
本社所在地 東京都港区西新橋一丁目 24 番 14 号
コード番号 8036 (東証・大証第一部)
問い合わせ先 コーポレート・コミュニケーション部 部長
加藤 弘之 (電話: 03-3504-5138)

米国にプロセスエンジニアリングセンタを設立

—顧客サポート力強化によりプロセス装置ビジネスを拡大—

株式会社日立ハイテクノロジーズ (執行役社長: 久田眞佐男/以下、日立ハイテク) は、半導体プロセス装置事業における海外顧客サポート体制の強化を目的に、米国オレゴン州ポートランド近郊にプロセスエンジニアリングセンタを設立することを決定しました。

日立ハイテクの 100%子会社である日立ハイテクノロジーズアメリカ会社 (社長: 宮崎正啓/本社: イリノイ州シカゴ) が運営する解析ラボを拡張し、クリーンルームを新設。設計・デモラボ機能などを備え、総床面積は約 3,800 m²、総投資額は約 24 億円を予定しています。本センタの開設により、顧客対応力の強化と効率的な事業運営を実現し、さらなる事業拡大を図ります。

日立ハイテクは、エッチング装置、評価装置、後工程・実装装置をラインアップした半導体製造装置事業において、日本国内・北米地域に加え、韓国・台湾などアジア地域に向け、グローバルに事業を展開してきました。

このたび新たに設立するプロセスエンジニアリングセンタは、日立ハイテクグループ初の、本格的な半導体製造装置の海外技術開発拠点です。今まで日立ハイテク・笠戸地区 (山口県下松市) を主拠点として行ってきた、プロセス装置の開発・設計・デモンストレーションなどを一貫して提供する機能を持たせることで、顧客ロードマップに同期した装置開発とタイムリーな性能実証を実現します。加えて、新たに開発したリンク式プラットフォーム(*)に搭載する、プロセスモジュール等の現地での組立や部品調達といった、これまで日本国内で行っていた機能の一部移管を目指すことで、事業規模の拡大に加え、生産リードタイムの短縮を図るとともに、円高による為替リスクの低減を図ります。

これらにより、海外顧客の開発サポート体制を一層拡充し、450mm ウェーハ対応製品の開発も視野に入れた、高効率でスピーディーな事業運営を推進してまいります。

同センタは、2013 年 3 月に着工、同年 9 月の完成を予定し、順次稼動を開始いたします。

日立ハイテクは、米国でのプロセスエンジニアリングセンタの設立を皮切りに、微細化、省電力化など先端技術への対応が求められる半導体プロセス装置事業の事業基盤をグローバルに整備・強化し、最先端顧客の開発パートナーとして JDP (Joint Development Program) を強力に推進することで、より一層の顧客提供価値の最大化を目指してまいります。

(*) リンク式プラットフォーム: 日立ハイテクが独自に開発した高速搬送システム。複数の真空搬送室をリンクさせることにより生産性を高め、あわせてモジュール化により各種プロセスチャンバー搭載可能な拡張性を実現。すでに最先端デバイス量産向けに受注を開始している。

以 上